

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于新产品研发进展的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）55nm 触控与显示驱动集成芯片（TDDI）实现大规模量产、40nm 高压 OLED 平台技术开发取得重大成果。为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品进展情况披露如下：

一、新产品基本情况

公司以显示驱动为切入点布局开发 55nm 制程技术平台，对工艺结构、流程进行自主设计和创新升级。目前公司已顺利完成 55nmTDDI 产品开发，且实现大规模量产。目前该产品产能达到满载状态，且已成功进入 LCD 面板及智能手机市场。为满足客户需求，公司预计将于本年度持续提升 55nm 产能。

同时，40nm 高压 OLED 平台开发取得重大成果，平台元件效能与良率已符合目标，具备向客户提供产品设计及流片的能力，公司预计本年度将建置产能以满足客户需要。

二、新产品研发对公司的影响

国内新型显示产业向价值链中高端迈进，公司紧抓机遇，持续拓展显示驱动芯片工艺平台，向高阶制程发展，产品应用逐渐覆盖 LCD、LED、AMOLED 等领域，以提升公司的核心竞争力，促进公司经营持续、健康、稳定发展，并助力本土产业加速升级。

三、相关风险提示

新产品研发取得重大进展到实现大规模量产尚需一定的周期和验证流程，且存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致项目效益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2023年6月21日